

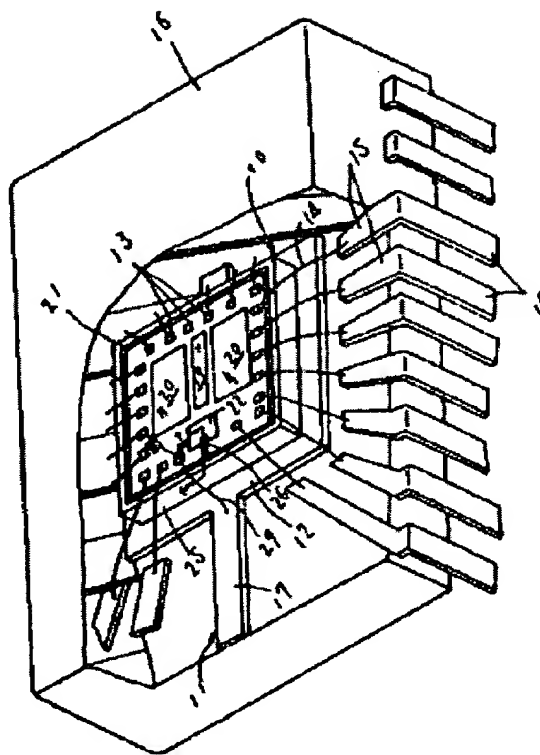
**SEMICONDUCTOR INTEGRATED CIRCUIT DEVICE**

**Patent number:** JP59092558  
**Publication date:** 1984-05-28  
**Inventor:** SHIBATA TAKASHI  
**Applicant:** HITACHI LTD  
**Classification:**  
- international: H01L21/88; H01L23/48; H01L27/04  
- european: H01L27/02B3B2  
**Application number:** JP19820201960 19821119  
**Priority number(s):** JP19820201960 19821119

Report a data error here

**Abstract of JP59092558**

**PURPOSE:** To exhibit bias effect over the entire region by impressing a substrate bias voltage over a guard ring provided in the periphery of a chip and entire region of the back surface of the chip. **CONSTITUTION:** The semiconductor chip 10 is fixed on a tab 12 of a lead frame 11. Thereby, the chip 10 and the tab 12 are electrically conducted. In the periphery of memory cells 20, electrode pads 13 are arranged, and the guard ring 21 is formed. The output line of a substrate bias generation circuit 22 is connected to the guard ring 21 and the tab 12, and the bias voltage is impressed over the periphery of the chip and the tab 12, i.e., entire region of the back surface of the chip 10.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

⑬ 日本国特許庁 (JP)  
⑭ 公開特許公報 (A)

⑮ 特許出願公開  
昭59—92558

⑯ Int. Cl.<sup>3</sup>  
H 01 L 27/04  
21/88  
23/48

識別記号

庁内整理番号  
B 8122—5F  
6810—5F  
7357—5F

⑰ 公開 昭和59年(1984)5月28日

発明の数 1  
審査請求 未請求

(全 5 頁)

⑱ 半導体集積回路装置

⑲ 特 願 昭57—201960  
⑳ 出 願 昭57(1982)11月19日  
㉑ 発 明 者 柴田隆嗣

小平市上水本町1450番地株式会

社日立製作所武蔵工場内  
㉒ 出 願 人 株式会社日立製作所  
東京都千代田区丸の内1丁目5  
番1号  
㉓ 代 理 人 弁理士 澤田利幸

明 細 書

発明の名称 半導体集積回路装置

特許請求の範囲

1. 半導体集積回路を形成した半導体チップ内に  
基板バイアス電圧発生回路を構成すると共に、こ  
の回路から発生される基板バイアス電圧を前記チ  
ップの周辺部に設けたガードリングとチップ表面  
とに夫々印加するように構成したことを特徴とす  
る半導体集積回路装置。

2. チップをリードフレームのタブ上に固着し、  
基板バイアス電圧をこのタブに供給してなる特許  
請求の範囲第1項記載の半導体集積回路装置。

発明の詳細な説明

本発明は半導体集積回路装置に関し、特に基板  
バイアス電圧発生回路を内蔵した半導体ICチ  
ップの基板にこのバイアス電圧を有効に加えるこ  
とができる半導体集積回路装置に関するものである。

絶縁ゲート電界効果トランジスタ(以下MIS  
FETと称する)で構成されたモノリシックIC  
においては、MISFETのソース領域、ドレイ

ン領域と半導体基板との間に形成されるpn接合  
の容量を減少させ回路としての動作速度を大きく  
させるため、及びMISFETのしきい値電圧を  
所望の値に制御するために、半導体基板に対して  
pn接合を逆バイアスさせるような極性の基板バ  
イアス電圧、例えば負の極性の基板バイアス電圧  
を加えることが行なわれる。

このため、第1図に示すように半導体チップ1  
の一部に、例えば発振回路と整流回路とから構成  
した基板バイアス電圧発生回路2を形成すると共  
に、チップ1の表面周辺部に素子パターンを包囲  
するガードリング3を設け、基板バイアス電圧発  
生回路2から発生された基板バイアス電圧をこの  
ガードリング3を通してチップ基板4に加えるよ  
うに構成している。しかしながら、この構成では  
ガードリング3近傍では基板バイアス電圧が有効  
に加えられることになるが、チップ中心部では基  
板の抵抗(シリコンの持つ抵抗)のため電圧降下  
が生じ、基板バイアス電圧の効果が不十分なもの  
になるという問題がある。

特開昭59-92558 (2)

したがって本発明の目的はチップの周辺部から中心部に回るチップ全域にわたって基板バイアス電圧を略等しく加え、これによりチップ全域において基板バイアス電圧効果を発揮することのできる半導体集積回路装置を提供することにある。

この目的を達成するために本発明はチップ表面周辺部のガードリングおよびチップの表面に夫々基板バイアス電圧を印加し、これによりチップパターン全域にわたって略等しく基板バイアス電圧を印加するものである。

以下本発明を図示の実施例により説明する。

第2図は本発明の半導体集積回路装置の一部破断斜視図であり、特にレジソモールド型のパッケージを備えた装置で例示してある。図において、半導体チップ10はその表面部位に所要の集積回路を形成してあり、リードフレーム11のタブ12上に金属ペースト或いはAu-Si共晶等によって固着している。これによって半導体チップ10をタブ12に電気的に導通させている。また、チップ10に設けた複数個の電極パッド13はAu

(3)

銅で形成されている。また、整流回路24は、例えば出力線L<sub>1</sub>とL<sub>2</sub>との間に接続されたキャパシタC<sub>1</sub>と、エンハンスメントモードのNチャネルMISFETQ<sub>1</sub>およびQ<sub>2</sub>とからなっている。図中G<sub>1</sub>、S<sub>1</sub>およびD<sub>1</sub>は夫々MISFETのゲート、ソースおよびドレインを要わしている。整流回路24の出力線V<sub>DD</sub>は各MISFETの共通の基体ゲートとしての半導体基板SUBに接続されており、一方C<sub>1</sub>は集積回路の接地配線と半導体基板との間の配線容量、ソースが接地されたMISFETのソースと半導体基板との間のpn接合容量などによって構成される半導体基板SUBと接地点GNDとの間の容量である。

このように構成された基板バイアス電圧発生回路22の出力線V<sub>DD</sub>は、第4図に示すように、チップ10に形成したガードリング21に配線層26を通して接続し、ガードリング21を通してチップ10の周辺部に基本バイアス電圧を印加している。図中、25はフィールド酸化膜、27は層間絶縁層であり、チップ10の基板10aをp型に、

(5)

又はn型のワイヤ14にて夫々インナリード15に接続している。そして、公知のモールド技術によってチップ10、タブ12、ワイヤ14等をレジソ材にてモールドし、パッケージ16を構成している。図中17はタブ12と一体のタブリード、18はインナリード15と一体のアウタリードである。

前記半導体チップ10は例えばメモリ素子として構成しており、その表面中央部にはデコーダ19を、またこのデコーダ19を挟む両側の大部分にはメモリセル20、20を形成している。そして、メモリセル20、20の周囲には前記電極パッド13を配列すると共に、更にその外周位置にはチップ外周辺に沿って棒状にガードリング21を形成し、かつこのガードリング21の周方向一部には基板バイアス電圧発生回路22を形成している。

前記基板バイアス電圧発生回路22は、第3図に示すように、発振回路23と整流回路24とを備え、発振回路23は奇数個のインバータ回路I<sub>V1</sub>、ないしI<sub>Vn</sub>、からなるリング発振回路によ

(4)

って構成されている。また、整流回路24は、例えば出力線L<sub>1</sub>とL<sub>2</sub>との間に接続されたキャパシタC<sub>1</sub>と、エンハンスメントモードのNチャネルMISFETQ<sub>1</sub>およびQ<sub>2</sub>とからなっている。図中G<sub>1</sub>、S<sub>1</sub>およびD<sub>1</sub>は夫々MISFETのゲート、ソースおよびドレインを要わしている。整流回路24の出力線V<sub>DD</sub>は各MISFETの共通の基体ゲートとしての半導体基板SUBに接続されており、一方C<sub>1</sub>は集積回路の接地配線と半導体基板との間の配線容量、ソースが接地されたMISFETのソースと半導体基板との間のpn接合容量などによって構成される半導体基板SUBと接地点GNDとの間の容量である。

一方、前記基板バイアス電圧発生回路22の近傍のチップ表面にはパッド28を設け、このパッド28には前記出力線V<sub>DD</sub>（またはガードリング21）を接続している。そして、このパッド28と前記タブ12と一体のタブリード17とをワイヤ29にて接続し、基板バイアス電圧をタブ12、即ちチップ（基板）10の表面全域に加え得るようにしている。

以上の構成によれば、基板バイアス発生回路では電源端子V<sub>DD</sub>に供給される正の電源電圧によって発振回路23は発振動作をする。出力線L<sub>1</sub>に出力される発振信号は、各インバータ回路I<sub>V1</sub>、～I<sub>Vn</sub>の遅延特性によって決った周波数となり、ほぼ接地電位の0ボルトとほぼ電源端子V<sub>DD</sub>の電源電圧に達するレベル振幅を持つ。発振回路23の出力線L<sub>1</sub>がほぼ電源電圧の正電位であるとき、MISFETQ<sub>1</sub>は、キャパシタC<sub>1</sub>を介してそ

(6)

特開昭59-92558 (3)

のドレインDに正の電圧を受けオン状態となる。キャパシタC<sub>1</sub>は段出力線L<sub>1</sub>の正電位からMISFETQ<sub>1</sub>のしきい値電圧を引いた値まで充電される。出力線L<sub>1</sub>の電位が段0がムトになると、線L<sub>1</sub>の電位はキャパシタC<sub>1</sub>の充電電圧によって負電位とされる。線L<sub>1</sub>の負電位によってMISFETQ<sub>1</sub>がオン状態となる。その結果、線V<sub>BB</sub>に結合しているコンデンサC<sub>2</sub>は線L<sub>1</sub>の負電位によって充電されるようになる。発振回路23の発振信号の1周期に一回ずつ上記のような充電が行なわれることにより、コンデンサC<sub>2</sub>には正の電源電圧に対応した負の基板バイアス電圧が発生される。

そしてこの基板バイアス電圧が出力線V<sub>BB</sub>からガードリング21およびタブ12に供給され、これらから夫々チップ10の周辺部、裏面に印加される。このため、第5図(A)に示すガードリング21によるチップ基板の基板バイアス電圧V<sub>BB</sub>による基板の実際の電位V<sub>sub</sub>と、同図(B)に示すタブ12によるチップ基板の基板バイアス電圧V<sub>BB</sub>による

(7)

でもタブの代りにセラミックベースのメタライズ層を利用することにより同様の効果を得ることができる。

以上のように本発明の半導体集積回路装置によれば、チップの周辺部に設けたガードリングと、チップの裏面全域の夫々に基板バイアス電圧を印加しているので、チップの周辺から中心にわたるチップ全域に略等しく基板バイアス電圧を印加することができるので、基板バイアス電圧の効果をチップ全域において発揮することができるという効果を奏する。

図面の簡単な説明

第1図は従来装置の平面図、

第2図は本発明装置の破断側視図、

第3図は基板バイアス電圧発生回路の回路図、

第4図は第2図のIV-IV線断面図、

第5図(A)~(C)は本発明の作用効果を説明するための電圧分布特性図である。

10…チップ、11…リードフレーム、12…タブ、15…インナリード、16…パッケージ、

(8)

基板の実際の電位V<sub>sub</sub>とが相乗することにより、チップ基板全体の基板バイアス電圧V<sub>BB</sub>による実際の基板の電位V<sub>sub</sub>の分布は同図(C)のようになり、チップ全域にわたって略等しい状態となる。即ち、ガードリング21のみでは同図(A)のように基板抵抗によって中心部の電位が高くなり、またチップ裏面からの印加のみでは同図(B)のように基板の厚さ方向の抵抗によって素子のされる基板表面部の電位が全体的に高くされていたものが、本例のようにガードリング21とタブ12の両方から基板バイアス電圧を印加することによって前述したような従来の電圧不均一の問題を解消することができる。これにより、チップの全域に渡ってその実際の電位V<sub>sub</sub>を略基板バイアス電圧に等しくでき、基板バイアス電圧の効果を十分に発揮させることができる。特に、チップが大サイズの場合や厚さの大きい場合にその効果は著しい。

ここで、前記実施例は一例にすぎず、ガードリングの形状や断面構造は適宜変更することができ、またセラミックパッケージ型の半導体装置におい

(9)

17…タブリード、18…アウトリード、21…ガードリング、22…基板バイアス電圧発生回路、28…パッド、29…ワイヤ、

代理人 弁理士 澤田利



特開昭59-82558 (4)

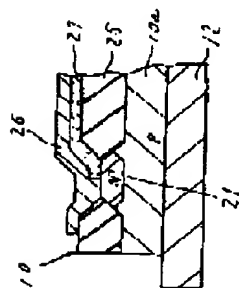


図 4

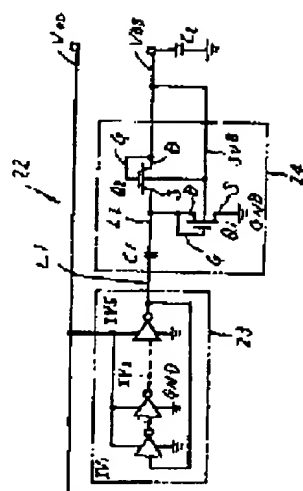


図 3

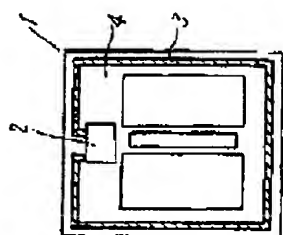


図 1

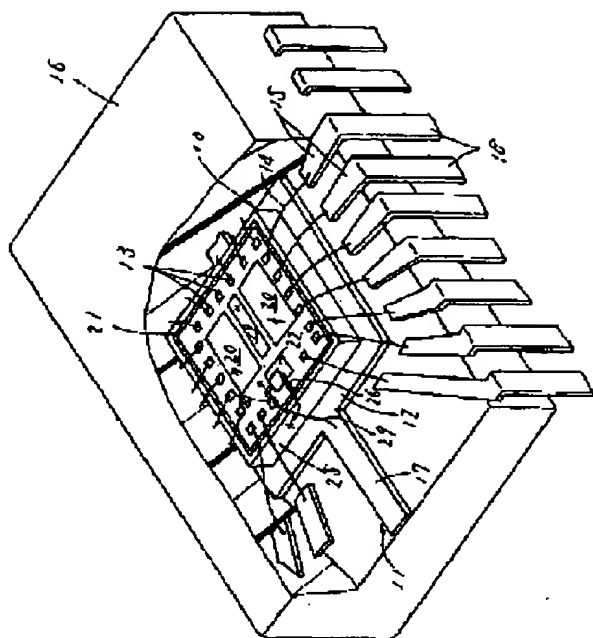
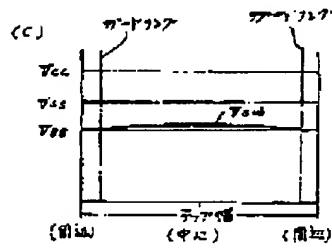
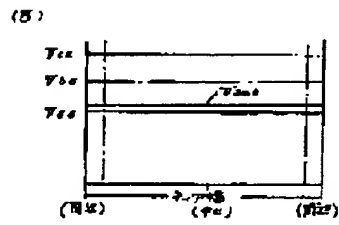
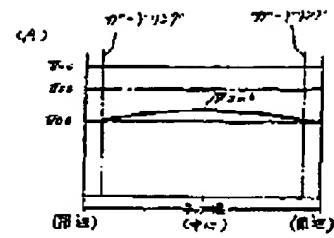


図 2

第 5 図



BEST AVAILABLE COPY